

## Verpackungstag 2018 Agenda – Das Networking-Event der Verpackungstechnik



### Maschinen für Smart Packaging Was sagen die Anwender dazu?

Vorläufiges Programm:

3. Verpackungstag, Heidelberg, Verpackungsmuseum

- 8.30 - 9.00** Registrierung, Ankunft der Gäste
- 9.00 - 9.15** Begrüßung Peter Schäfer, agt agile technik verlag
- 9.15 - 9.45** **Keynote: Was ist der Kern der Digitalisierung an der Verpackungsmaschine?**  
Strategien und Beispiele: Selbstlernendes Bediener-Assistenzsystem und Reinigungssysteme an der Maschine.  
Dr. Lukas Oehm, Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV, Dresden
- 9.45 - 10.15** **Wie arbeiten Mensch und Maschine in Harmonie zusammen?**  
Wie funktioniert nahtlose Datenintegration aller Systeme in der personalisierten Produktion vom Shop-Floor bis zur MES-Ebene?  
Gemeinsam mit einem Partner aus der Systemintegration zeigt Omron praktische Beispiele.  
Arnd Neues/ Lucian Dold, Omron Electronics GmbH
- 10.15 - 11.00** Kaffeepause - Rundgang durch die Micro Fair
- 11.00 - 11.30** **Digitalisierung von integrierten Verpackungsanlagen:  
Chancen und Herausforderungen**  
Wie kann ein Maschinenbauer die Flexibilität, Effizienz, Innovativität und Nachhaltigkeit der Verpackung von Süßwaren als Partner seiner Kunden verbessern?  
Dr. Thomas Cord, Geschäftsführer, Loesch Verpackungstechnik GmbH
- 11.30 - 12.00** **Smart Machine beim Endkunden, Herausforderungen und Lösungen**  
Stefan Mergel, Senior Product Manager Equipment, SIG Combibloc  
Reinholt Schlechter, OEM Segment Manager Material Handling & Packaging, Schneider Electric
- 12.00 - 12.30** **Gemeinsam zur besseren Performance**  
Digital vernetzte Systeme sind die Basis einer immer besseren Wertschöpfung sowie höherer Flexibilität, Effizienz und Produktivität im Verpackungsprozess.  
Horst Klesse und Dr. Elmar Büchler zeigen, wie vertikale und horizontale Integration der Daten funktioniert, und welchen Nutzen ELOPAK als Anwender hat, wenn alles ab Shopfloor vernetzt ist.  
Horst Klesse, Manager Electrical Design Electrics & Controls, ELOPAK EQS GmbH  
Dr. Elmar Büchler, Industry Strategy and Marketing Manager, Balluff GmbH

**12.30 - 13.45** Mittagspause - Networking und Besuch der Micro Fair

**13.45 - 14.00 Impulsvortrag**

Persil und einiges mehr – das Verpackungsmuseum  
Hubert Harmann, ehem. Henkel

**14.00 - 14.30 Der Wandel des Services – Digitalisierung im Maschinenbau**

Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung erklärt am Beispiel einer aseptischen Abfüllmaschine.

Daniela Kraft, VMS ASEPTIC FILLING

Joerg Peters, Leiter Product Solution, SEW-EURODRIVE

**14.30 - 16.00** Kaffeepause –

Networking und Rundgang durchs Verpackungsmuseum

**16.00 - 16.30 Serienreife in Losgröße 1!**

Zeit ist Geld: 3D-Druck trifft Verpackungsmaschine. Was hat der 3D-Druck mit Spotify zu tun? Gezeigt wird wie die Vorfertigung und Durchlaufzeiten verkürzt werden.

Marcus Schindler, Gerhard Schubert GmbH

**17.00 - 17.30 Publikumsgespräch**

Was sagen die Anwender zu den auf dem 3. Verpackungstag vorgestellten Lösungen?

**17.30 Verabschiedung**

